

高精度倒装键合机 (Solder Bump) - 评标结果公示公告

项目名称：高精度倒装键合机 (Solder Bump)

招标项目编号：0664-2340SUMECK67/07

招标范围：高精度倒装键合机 (Solder Bump)

招标机构：苏美达国际技术贸易有限公司

招标人：北京芯力技术创新中心有限公司

开标时间：2024-01-31 10:00

公示开始时间：2024-02-04 17:57

评标公示截止时间：2024-02-07 23:59

中标候选人名单：

| 候选人排名 | 投标商名称 | 制造商 | 制造商国别及地区 |
|-------|------------|--------|----------|
| 1 | 北京华封科技有限公司 | CAPCON | 新加坡 |

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： 邓梦诗 （签名）

招标人或其招标代理机构： 苏美达国际技术贸易有限公司 （盖章）

